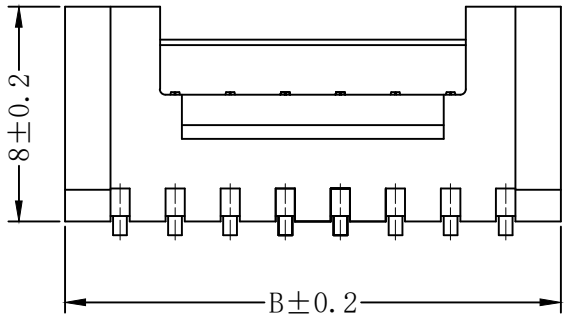
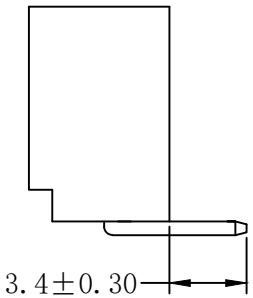
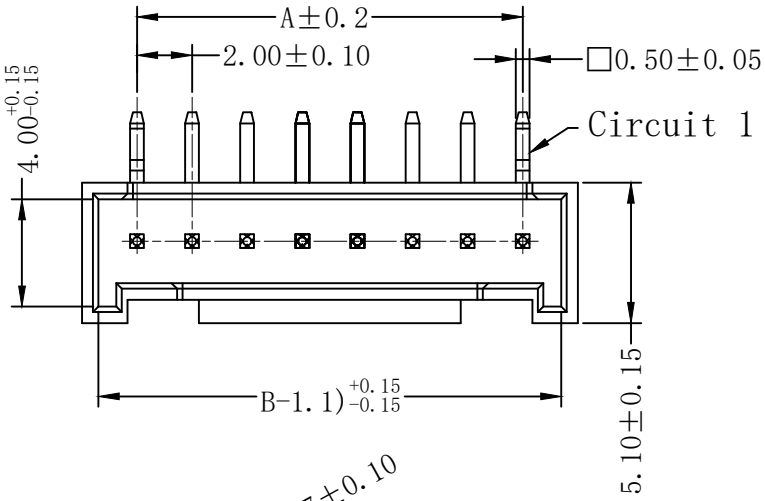
REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	

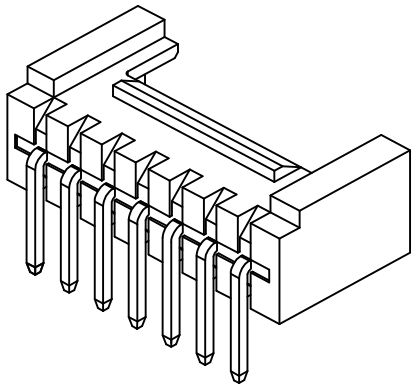
技术要求：

1、塑件材料：CM3004（UL-94V-0）
2、接触件：黄铜镀锡
3、接触电阻：≤10mΩ
4、绝缘电阻：≥1000MΩ
5、额定电压：250V AC DC
6、额定电流：2.0A AC DC
7、耐压：能承受1000V AC/Minute
8、工作温度：-25° ~~+85°
9、可焊性试验：浸锡面积≥95%温度220$^{+5}_{0}$°,时间2.5±0.5秒
10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求

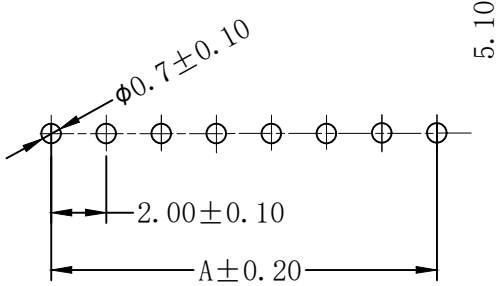








Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	2.00	6.10	2.50
03	4.00	8.00	2.50
04	6.00	10.00	3.50
05	8.00	12.00	5.50
06	10.00	14.00	7.50
07	12.00	16.00	9.50
08	14.00	18.00	11.50
09	16.00	20.00	13.50
10	18.00	22.00	15.50
11	20.00	24.00	15.50
12	22.00	26.00	15.50
13	24.00	28.00	15.50
14	26.00	30.00	15.50
15	28.00	32.00	15.50



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

序号	名 称	材 料	数 量	附 注
2	端子 Contact	黄铜	n×1	电镀(镀): 整个表面镀底镍30u"MIN,焊锡镀 80u"MIN..
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	白色

GENERAL TOLERANCES			DRAWN BY	深圳市宝通成电子有限公司	
0.X ±0.25	X.° ±3°		CHK. BY		
0.XX ±0.12			APRV. BY	SHEET	PROD. NAME HY2.0 弯针 2P
0.XXX ±0.05	X.X° ±0.5°		DRAWING NO.	1 OF 1	PART NO. BTC-HY2.0-N*PWZ
UNIT	SIZE	SCALE		TITLE	
MM	A4	1:1			

借用登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期